

Title (en)

Temperature of cooking vessels sensing method and device

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung der Temperatur eines Kochgefäßes

Title (fr)

Procédé et dispositif de détection de la température d'un ustensile de cuisine

Publication

EP 1217873 A2 20020626 (DE)

Application

EP 01128793 A 20011204

Priority

DE 10064621 A 20001221

Abstract (en)

The device has at least one flat measurement element (15,17) near a heating zone (3) on the upper side of the cooking plate (2) with an upper side for contact with the bottom of the cooking vessel (25) and a device (8) for determining the temperature of the measurement element in the form of one or more infrared sensors. Independent claims are also included for the following: an electric heating device with as cooking plate and a method of detecting temperature of cooking vessel.

Abstract (de)

Beschrieben werden eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Erfassung der Temperatur eines Kochgefäßes (25), das auf einer Kochplatte eines Wärmegerätes, beispielsweise auf der Glaskeramikplatte (2) eines induktiven Kochherdes (1), im Bereich einer Heizzone (3) aufgestellt ist. Im Bereich der Heizzone (3) ist auf der Oberseite der Kochplatte mindestens ein, beispielsweise durch eine Farbschicht gebildetes, flaches Meßelement (15, 16, 17) angebracht, dessen Oberseite (18, 19, 20) bei Aufstellen des Kochgefäßes (25) in flächigem Berührungskontakt mit dem Kochgefäßboden (26) tritt. Dadurch gleicht sich die Temperatur des Meßelementes (15, 16, 17) durch Wärmeleitung der Kochgefäßtemperatur zuverlässig an, so daß durch Bestimmung der Meßelementtemperatur die Kochgefäßtemperatur bestimmbar ist. Das Meßelement (15, 16, 17) kann als Referenzmeßfläche zur Infrarottemperaturmessung durch die Kochplatte hindurch genutzt werden, wobei die Genauigkeit der Temperaturmessung unabhängig ist von der Emissionsfähigkeit des aufgestellten Kochgefäßes (25). <IMAGE>

IPC 1-7

H05B 3/74

IPC 8 full level

H05B 3/74 (2006.01); **H05B 6/12** (2006.01)

CPC (source: EP US)

F24C 15/083 (2013.01 - EP US); **H05B 3/746** (2013.01 - EP US); **H05B 6/062** (2013.01 - EP US); **H05B 2213/07** (2013.01 - EP US)

Cited by

EP1643807A4; FR2965330A1; WO2013034528A1; EP2241822A2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1217873 A2 20020626; **EP 1217873 A3 20031105**; **EP 1217873 B1 20060628**; AT E332071 T1 20060715; AU 781345 B2 20050519; AU 9725901 A 20020822; DE 10064621 A1 20020627; DE 50110327 D1 20060810; ES 2267657 T3 20070316; US 2003206572 A1 20031106

DOCDB simple family (application)

EP 01128793 A 20011204; AT 01128793 T 20011204; AU 9725901 A 20011213; DE 10064621 A 20001221; DE 50110327 T 20011204; ES 01128793 T 20011204; US 3387501 A 20011219